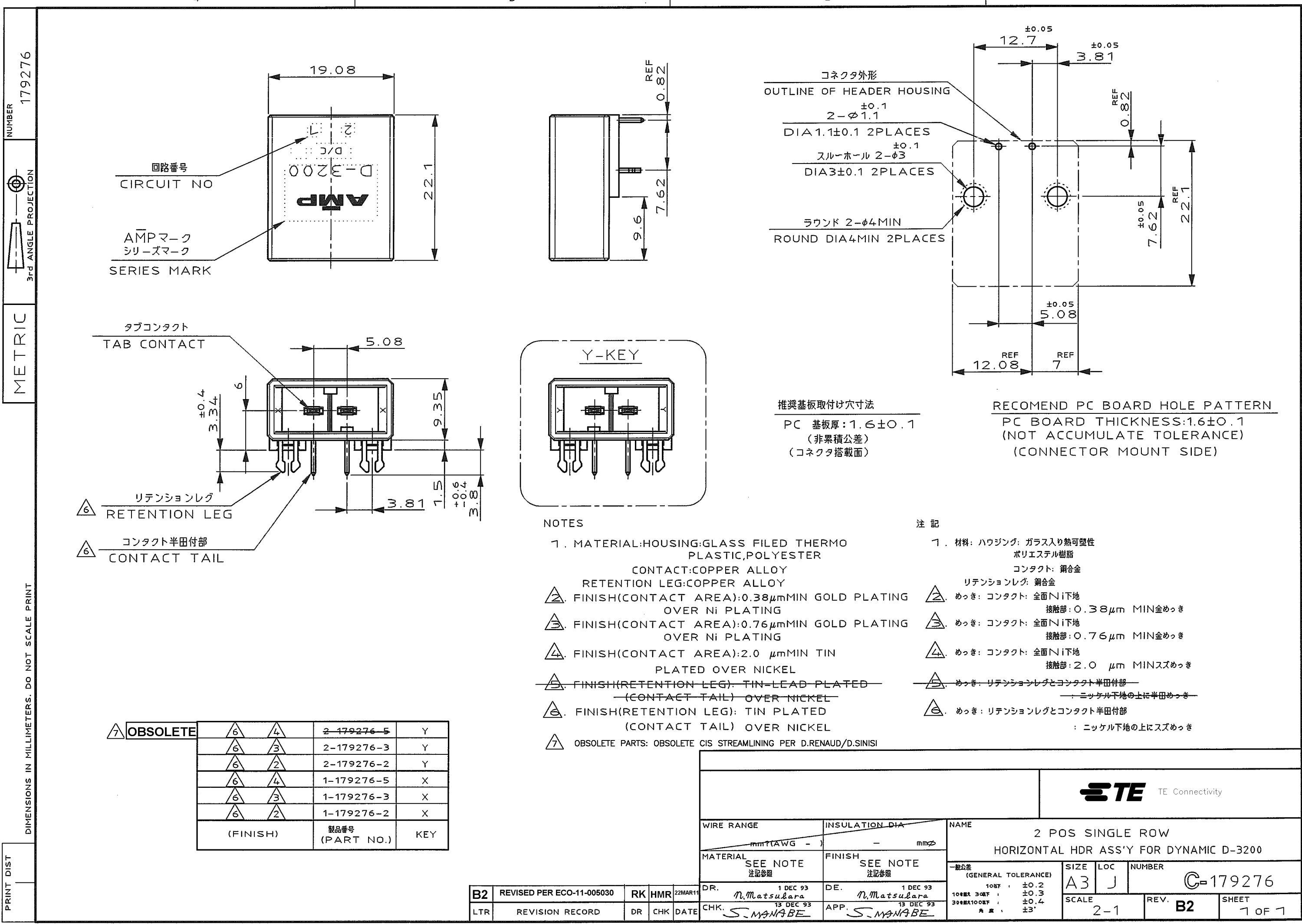




NUMBER
179276

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

回路番号
CIRCUIT NO

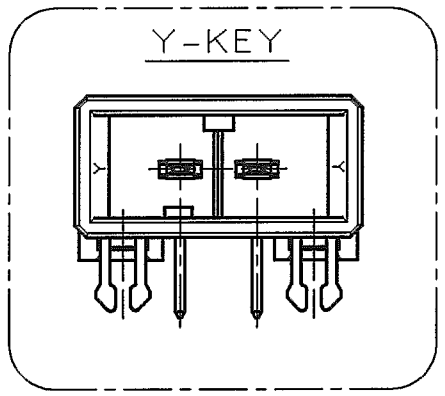
AMPマーク
シリーズマーク
SERIES MARK

タブコンタクト
TAB CONTACT

リテンションレグ
RETENTION LEG

コンタクト半田付部
CONTACT TAIL

△ OBSOLETE	6	4	2-179276-5	Y
	6	3	2-179276-3	Y
	6	2	2-179276-2	Y
	6	4	1-179276-5	X
	6	3	1-179276-3	X
	6	2	1-179276-2	X
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)	KEY	



NOTES

- MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △ 2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △ 3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △ 4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △ 5. ~~FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
- △ 6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △ 7. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING

2-φ1.1
DIA 1.1±0.1 2PLACES

スルーホール 2-φ3
DIA 3±0.1 2PLACES

ラウンド 2-φ4MIN
ROUND DIA 4MIN 2PLACES

推奨基板取付け寸寸法
PC 基板厚:1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

注記

- 材料:ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- △ 2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- △ 3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- △ 4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- △ 5. めっき: ~~リテンションレグとコンタクト半田付部~~
~~ニッケル下地の上に半田めっき~~
- △ 6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

B2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	22MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE mm ² (AWG -)		INSULATION DIA mmφ	NAME 2 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE A3
DR. 1 DEC 93 N. Matsubara		DE. 1 DEC 93 N. Matsubara	10mmF : ±0.2 10mmE 30mmF : ±0.3 30mmE 100mmF : ±0.4 角 度 : ±3°	LOC J
CHK. 13 DEC 93 S. MANABE		APP. 13 DEC 93 S. MANABE	SCALE 2-1	NUMBER C=179276
		REV. B2		SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面